

5. SYMPOSIUM ELEKTRONIK UND SYSTEMINTEGRATION

15. APRIL 2026
HOCHSCHULE LANDSHUT

**SYMPOSIUM ESI 2026:
ZUKUNFT GESTALTEN – ELEKTRONIK
ALS GRUNDLAGE VON INNOVATIONEN**

EINLADUNG UND PROGRAMM





5. SYMPOSIUM ELEKTRONIK UND SYSTEMINTEGRATION

EINLADUNG ZUM EXPERTENTREFF

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz bestimmen viele Entwicklungen in Beruf und Alltag. Doch ob es sich um Handys, Computer, Daten- und Energieströme oder viele Innovationen im Gesundheitsbereich handelt: Elektronik bildet die Grundlage für die technologischen Entwicklungen aber auch für den Wohlstand im digitalen Zeitalter.

Die Hochschule Landshut bietet mit ihren Symposien im Bereich der (Mikro-)Elektronik seit nahezu zwei Jahrzehnten eine Plattform für den Austausch von Industrie und Forschung. Das „5. Symposium Elektronik und Systemintegration (ESI)“ wird am 15. April 2026 wieder aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen zeigen.

In drei Plenarvorträgen sowie Fachvorträgen in parallelen Sessions werden Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Industrie neueste Produkte und Erkenntnisse prä-

sentieren. Neben den Vorträgen werden wissenschaftlich ausgearbeitete Beiträge der Referentinnen und Referenten online veröffentlicht und den Teilnehmenden in Form eines digitalen Tagungsbandes zu Verfügung gestellt. Die begleitende Fachaussstellung und auch eine Postersession stellen eine hervorragende Gelegenheit dar, aktuelle Erkenntnisse und Produkte einem Expertenpublikum zu zeigen und mit diesem ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltung wird vom Forschungsbereich Elektronik und Systemintegration und dem Cluster Mikrosystemtechnik der Hochschule Landshut organisiert. Das Symposium findet im Turnus von zwei Jahren statt.

Wir laden Sie herzlich zum Expertentreff 5. Symposium ESI 2026 ein und würden uns freuen, Sie an der Hochschule Landshut begrüßen zu können.

GRUSSWORT HOCHSCHULPRÄSIDENTIN



Für die Hochschule Landshut stellt neben den Handlungsfeldern Lehre, und Forschung der Wissenschaftstransfer, bestehend aus Wissens- und Technologietransfer, eine wichtige Aufgabe dar. Besonders vor dem Hintergrund der aktuellen komplexen und rasanten Transformationsprozesse, die Wirtschaft und Gesellschaft vor große Herausforderungen stellen, können und sollten wissenschaftliche Erkenntnisse wichtige Impulse liefern sowie einen wertvollen Beitrag für Innovation in

Wirtschaft und Gesellschaft leisten.

Dabei ist die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis grundlegend, um relevante Handlungsfelder und Bedarfe erkennen und aufnehmen zu können sowie gemeinsam relevante Forschungserkenntnisse zu generieren. Für die notwendige Vernetzung von Wissenschaft und Praxis bietet das Symposium Elektronik und Systemintegration einen fruchtbaren Boden. In Fachvorträgen mit anschließender Diskussion, einem begleitenden Tagungsband sowie Fachaussstellung

und Postersession schafft das Symposium nicht nur Raum für Wissenstransfer, sondern auch für den persönlichen Austausch und das Networking.

Der Forschungsbereich Elektronik und Systemintegration und der Cluster Mikrosystemtechnik der Hochschule Landshut bieten bereits seit dem Jahr 2008 in ihren Symposien Raum für neuste Erkenntnisse und die Vernetzung. Viele Ideen und gemeinsame Projekte unter Beteiligung von Unternehmen und weiteren Forschungseinrichtungen sind daraus entstanden.

Ich lade Sie herzlich zum 5. Symposium Elektronik und Systemintegration an die Hochschule Landshut ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich über aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen zu informieren, zum Fachaustausch und zum Netzwerken mit dem Ziel, gemeinsam Innovationen zu schaffen.

Prof. Dr. Michaela Wirtz
Präsidentin der Hochschule Landshut

5. SYMPOSIUM ELEKTRONIK UND SYSTEMINTEGRATION

ZUKUNFT GESTALTEN – ELEKTRONIK ALS GRUNDLAGE VON INNOVATIONEN

Das 5. Symposiums ESI bietet in insgesamt 28 Vorträgen ein breites Fachprogramm, aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen aus Wissenschaft und Praxis. Für die Qualität der Vorträge und auch des begleitenden Tagungsbandes bürgt ein Fachkomitee, bestehend aus Experten aus Universitäten, Hochschulen und Unternehmen. Die Bandbreite der Beiträge reicht von Fragestellungen in der Aufbau- und Verbindungstechnik sowie innovativen Sensorik-Konzepten über KI-Anwendungen und Nachhaltigkeit im Elektronikumfeld bis hin zum 3D-Druck und der elektrochemischen Zunge.

ANSPRUCHSVOLLES FACHPROGRAMM

In Plenumsvorträgen und Sessions mit je zwei parallelen Fachvorträgen werden Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Dienstleistung auch beim 5. Symposium Elektronik und Systemintegration vielfältige Themen beleuchten. Aus den eingegangenen Vortragsangeboten hat das Fachkomitee wieder ein anspruchsvolles Fachprogramm zusammengestellt.

Drei Plenumsvorträge bilden den Auftakt: „Chiptainability – Nachhaltigkeits-Innovationen in der Mikroelektronik-Industrie“ lautet das Thema des Vortrags von Stefan Wunderer (Nokia Mobile Infrastructure, Ulm). Mit „MEMS-IR-Emitter: Vom digitalen Zwilling über neuartige Verbindungstechniken bis hin zu standardisierten Messprotokollen“ wird sich Toni Schildhauer (CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt) befassen. Stefan Betzold (BURGER ENGINEERING GmbH & Co. KG, Schwaig) wird Entwicklungen von „AI in Embedded Systems / Edge-AI for Motor Control KI-Anwendungen im Elektronikbereich“ aufzeigen. 24 weitere Fachvorträge bieten Themen in folgenden Sessions:

- Aufbau- und Verbindungstechnik
- Intelligente Steuerungssysteme
- KI-Anwendungen im Elektronikbereich

- Nachhaltigkeit im Elektronikumfeld
- Sensorik
- Systemkomponenten und Systemintegration
- Vernetzte Systeme – industrielle Anwendung

TAGUNGSBAND | FACHAUSSTELLUNG

Zusätzlich zu den Vorträgen werden von den Referentinnen und Referenten des Symposiums eingereichte wissenschaftlich ausgearbeitete Beiträge im Tagungsband (Review durch das Fachkomitee) publiziert. Den Teilnehmern/-innen des Symposiums stellen wir den Tagungsband online zur Verfügung, später werden die Beiträge für die gesamte Fachwelt (Open Source) zugänglich sein.

Die begleitende Fachausstellung und die Postersession bieten Gelegenheit, sich über den aktuellen Stand von Technologien, neue Forschungserkenntnisse sowie innovative Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Zusammen mit unseren Partnern, bei denen wir uns ebenso wie bei allen Referenten/-innen und dem Fachkomitee herzlich für ihre Unterstützung bedanken, wollen wir den fachlichen Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie zwischen Kunden und Anwendern in den Mittelpunkt stellen.

Nutzen Sie das Symposium, das Ihnen aktuelles Wissen und Diskussionen über die Herausforderungen, Trends und Entwicklungen rund um die Themenfelder der Elektrotechnik bietet, auch als Plattform für den Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen. Weitere Informationen zum 5. Symposium ESI sowie die Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie im Internet unter www.symposium-esi.de.

Prof. Dr. Artem Ivanov
Hochschule Landshut

SYMPOSIUM ELEKTRONIK UND SYSTEMINTEGRATION

Die Symposium ESI hat sich zum wichtigen und angesehenen Branchentreff etabliert. Es bietet eine technologie- und branchenübergreifende Plattform, die sich an Entscheidungsträger/-innen und Mitarbeiter/-innen von Unternehmen und Dienstleistern, Forschungseinrichtungen, Verbände und alle Interessierten richtet. Die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltungsreihe wird vom Forschungsbereich Elektronik und Systemintegration und vom Cluster Mikrosystemtechnik der Hochschule Landshut organisiert, die wissenschaftliche Leitung liegt bei Prof. Dr. Artem Ivanov (Foto).



5. SYMPOSIUM ELEKTRONIK UND SYSTEMINTEGRATION

PROGRAMM | MITTWOCH, 15. APRIL 2026

ab 08:00 Uhr	Registrierung	
09:00 - 09:20	Auftakt	
	Begrüßung Prof. Dr. Marcus Jautze Vizepräsident Transfer und Internationales, Hochschule Landshut	
	Einführung Prof. Dr. Artem Ivanov Cluster Mikrosystemtechnik, Hochschule Landshut	
09:20 - 10:45	Vorträge im Plenum	
	Chiptainability – Nachhaltigkeits-Innovationen in der Mikroelektronik-Industrie Stefan Wunderer Nokia Mobile Infrastructure, Ulm	
	MEMS-IR-Emitter: Vom digitalen Zwilling über neuartige Verbindungstechniken bis hin zu standardisierten Messprotokollen Toni Schildhauer CiS Forschungsinstitut für Mikrosensoren GmbH, Erfurt	
	AI in Embedded Systems / Edge-AI for Motor Control Stefan Betzold BURGER ENGINEERING GmbH & Co. KG, Schwaig	
	Präsentation Fachaussteller / Poster Prof. Dr. Artem Ivanov Cluster Mikrosystemtechnik, Hochschule Landshut	
10:45 - 11:15	Kaffeepause Besuch der Fachausstellung	
PARALLEL-SESSION 1	A1: SYSTEMKOMPONENTEN UND SYSTEMINTEGRATION Moderation: Prof. Dr. Artem Ivanov Hochschule Landshut	B1: VERNETZTE SYSTEME - INDUSTRIELLE ANWENDUNG Moderation: Prof. Dr. Jürgen Welter Hochschule Landshut
	11:15 - 11:40	Fast Steering Mirrors für laserbasierte Satellit zu Satellit Kommunikation im Weltraum Tobias Schopf, MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG, Ortenburg
11:40 - 12:05	Exploring Measurement Techniques and Challenges in Silicon Based Field Emission Arrays Ali Asgharzade, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg	Interoperable Digitale Zwillinge als Enabler für datengetriebene Instandhaltung und Betriebsführung Farhad Ghadaki, DRIESCHER ENERGY SOLUTIONS GMBH, Moosburg
12:05 - 12:30	Anschärfung von Feldemissionsspitzen durch Aufwachsen kohlenstoffhaltiger Strukturen Fabian Hecht, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg	Embedded IoT Sensorsystem als dezentrale Peripherie mit Power over Ethernet Fabian Repking, Technische Hochschule Rosenheim
12:30 - 12:55	3-D gedruckte Linsen für industrielle Radar-Sensoren im D-Band Dr. Peter Uhlig, IMST GmbH, Kamp-Lintfort	Einführung in die Treiberentwicklung für Zephyr RTOS am Beispiel eines Ethernettreibers Korbinian Salzborn, Ingenics Digital GmbH, Gräfelfing
12:55 - 14:00	Mittagspause Besuch der Fachausstellung	

5. SYMPOSIUM ELEKTRONIK UND SYSTEMINTEGRATION

PROGRAMM | MITTWOCH, 15. APRIL 2026

PARALLEL-SESSION 2	A2: KI-ANWENDUNGEN IM ELEKTRONIKBEREICH Moderation: Dr. Stefan Müller DRÄXLMAIER Group, Vilsbiburg	B2: AUFBAU- UND VERBINDUNGSTECHNIK Moderation: Prof. Dr. Gregor Feiertag Hochschule München
14:00 - 14:25	AI in Altera FPGAs Wolfgang Loewer, El Camino GmbH, Mainburg	3D Wirebonder Dr. Bernhard Rebhan, F&S BONDTEC Semiconductor GmbH, Braunau am Inn (A)
14:25 - 14:50	KI mit nur einem Klick! Helmut Plötz, ONE WARE GmbH, Brakel	3-Level Flying Capacitor Leistungsmodul auf IMS-Leiterplatte für DCDC-Wandler Tobias Eckert, Hochschule Landshut
14:50 - 15:15	KI in der halbleiterbasierten DC-Schutztechnik - Was bedeutet Current Fedded Power Fencing@SSPC? Maik Hohmann, Temes Engineering GmbH, Otterfing	Aufbautechnik eines 800 V Leistungsmoduls mit TO-263 SiC-MOSFETs auf Metallkernleiterplatte Bernhard Jahn, Hochschule Landshut
15:15 - 16:00	Kaffeepause Besuch der Fachausstellung	
PARALLEL-SESSION 3	A3: SENSORIK I Moderation: Prof. Dr. Rupert Schreiner Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg	B3: NACHHALTIGKEIT IM ELEKTRONIKUMFELD Moderation: Prof. Dr. Elisabeth Berger Hochschule Landshut
16:00 - 16:25	2- und 3-Omega Messungen mit thermischen Sensoren zur Bestimmung von Vakuum, Wandschubspannung und Gaskonzentrationen Julian Eiler, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg	Kreislaufwirtschaft von Elektrolyseuren: Zirkuläre Ansätze und Methode zur Bewertung des Kreislaufpotenzials von Elektrolyseur-Komponenten Florian Hoffmann, Hochschule Landshut
16:25 - 16:50	Automatisierte Charakterisierung und Qualitätsbewertung von Spannungsverstärkern für ALTP-Wärmestromsensoren Simon Kaneider, Hochschule Landshut	Auslegung von anorganisch-organischen Hybridpolymeren für gesteigerte Anforderungen im Bereich elektronischer Systeme Gerhard Domann, Fraunhofer Institut für Silicatforschung ISC, Würzburg
16:50 - 17:15	Entwicklung einer zeitlich hochaufgelösten Schaltung für die simultane Messung von Wärmestrom und Temperatur mittels ALTP-Sensoren Claudia Hofmann, Hochschule Landshut	Ring-type surface dielectric barrier discharge as a plasma source for enhancing germination rates in tomato seeds Abdurrahman Musazay, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
PARALLEL-SESSION 4	A4: SENSORIK II Moderation: Prof. Dr. Christian Faber Hochschule Landshut	B4: INTELLIGENTE STEUERUNGSSYSTEME Moderation: Prof. Dr. Mathias Rausch Hochschule Landshut
17:20 - 17:45	Vom Multielektroden-Array zur elektrochemischen Zunge: Intelligente elektrochemische Sensoren auf Basis von Metalloxiden Josef Schottenbauer, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden	Mikrocontroller-basierte Steuerung von 24-Bit AD Umsetzern und Integration von Dehnungsmessstreifen auf einer Leiterplatte zur parallelen Gewichtsmessung Christoph Bernauer, Technische Hochschule Rosenheim
17:45 - 18:10	Messsystem zur kontaktlosen Erfassung von Betriebs-schwingungen einer Violine unter realen Spielbedingungen Prof. Dr. Artem Ivanov, Hochschule Landshut	Model Predictive Control (MPC) zur Generierung realistischer Motorradfahrdynamikdaten Alexander Schön, Hochschule Landshut
Vortrag im Plenum Abschluss		
18:15 - 18:40	Thread-basierte Sensornetzwerke im industriellen Umfeld Andreas Hofmeister, Sensorik-Bayern GmbH, Regensburg	
ab 18:40	Ausklang Get together	

5. SYMPOSIUM ELEKTRONIK UND SYSTEMINTEGRATION

ZUKUNFT GESTALTEN – ELEKTRONIK ALS GRUNDLAGE VON INNOVATIONEN

VORTRAGSPROGRAMM

Im Mittelpunkt des 5. Symposiums Elektronik und Systemintegration steht der Austausch von aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen aus Wissenschaft und Forschung. Das Programm bietet eine große Themenbreite über unterschiedliche Technologien und Branchen hinweg. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie im Folgenden oder unter www.symposium-esi.de. Hier können Sie sich auch online zur Veranstaltung anmelden.

FACHAUSSTELLUNG

Neben den Vorträgen stellt aber auch die parallel stattfindende Fachausstellung einen wesentlichen Bestandteil des Symposiums dar. Für das Fachpublikum bietet diese Plattform eine ideale Gelegenheit, sich über den aktuellen Stand von Technologien, neue Forschungserkenntnisse sowie innovative Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Aussteller präsentieren sich einem ausgewählten Kreis an Besuchern. Das Ziel lautet, neue Kontakte zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen zu knüpfen sowie bereits bestehende Beziehungen zu intensivieren.

Die Teilnahme als Aussteller ist kostenpflichtig, für Netzwerk-Partner gelten Sonderkonditionen. Nähere Informationen zu den Teilnahmebedingungen für Fachaussteller finden Sie unter dem Punkt „Teilnahme als Aussteller“ auf der folgenden Seite oder unter www.symposium-esi.de.

TAGUNGSBAND | ONLINE-PUBLIKATION

Parallel zu den Vorträgen konnten die Referentinnen und Referenten des Symposiums bisher unveröffentlichte Themen als wissenschaftlich ausgearbeitete Beiträge einreichen. Diese werden im digitalen Tagungsband pünktlich zur Veranstaltung publiziert. Freigegebene Beiträge werden zu einem späteren Zeitpunkt in der OPUS-Datenbank über die Deutsche Nationalbibliothek online gestellt. Für die Qualität der Beiträge sorgt der Auswahlprozess durch das Fachkomitee, das Änderungsvorschläge erarbeitet und abschließend über die Veröffentlichung im Tagungsband entscheidet (peer review).

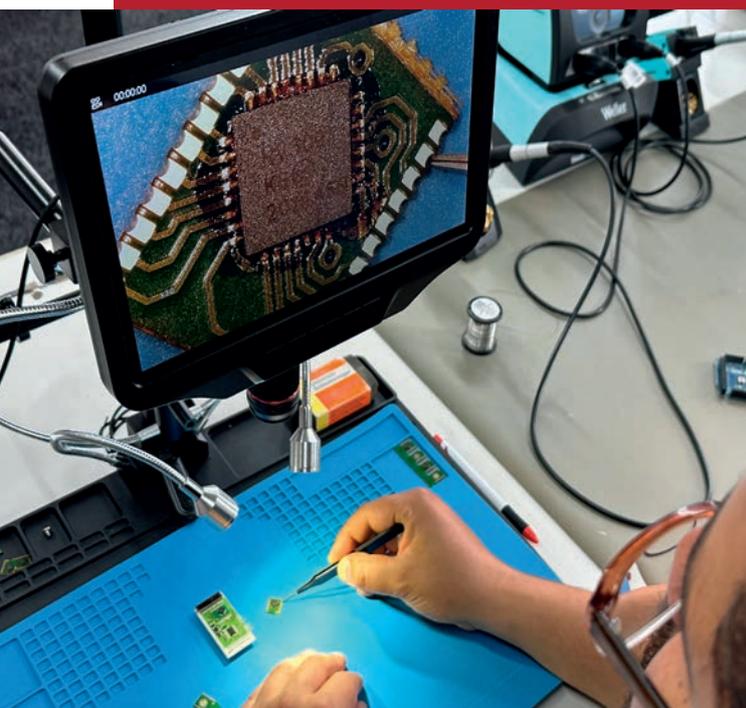
POSTERSESSION

Unternehmen, Start-ups, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Absolventinnen und Absolventen sowie Studierende, die für das Symposium angemeldet sind, können innovative Produkte, Neuentwicklungen sowie Ergebnisse von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in einer Postersession vorstellen. Das Fachkomitee entscheidet über die Zulassung von Plakaten. Die Präsentation eines Posters ist kostenfrei, eine Anmeldung zur Postersession ist über das entsprechende Formular unter www.symposium-esi.de notwendig.

FACHKOMITEE

Die Qualität der technisch-wissenschaftlichen bzw. praxisbezogenen Vortragsangebote und der Tagungsbandbeiträge zum Symposium Elektronik und Systemintegration wird von einem Fachkomitee, bestehend aus Experten aus Wissenschaft und Industrie, geprüft. Das Fachgremium steht für die hohe Qualität der Veranstaltung sowie des Tagungsbandes.

- Dr. Heike Bartsch, TU Ilmenau
- Prof. Dr. Mikhail Chamonine, OTH Regensburg
- Prof. Dr. Ignaz Eisele, Fraunhofer EMFT, München
- Prof. Dr. Christian Faber, Hochschule Landshut
- Prof. Dr. Gregor Feiertag, Hochschule München
- Prof. Dr. Artem Ivanov, Hochschule Landshut
- Dr. Thomas Maier, Schott AG, Landshut
- Prof. Dr. Jörg Mareczek, Hochschule Landshut
- Prof. Dr. Jürgen Mottok, OTH Regensburg
- Dr. Stefan Müller, DRÄXLMAIER Group, Vilsbiburg
- Prof. Dr. Mathias Rausch, Hochschule Landshut
- Prof. Dr. Christina Schindler, Hochschule München
- Prof. Dr. Rupert Schreiner, OTH Regensburg
- Prof. Dr. Martin Sellen, MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG, Ortenburg
- Dr. Peter Uhlig, IMST GmbH, Kamp-Lintfort
- Marcus Zimnik, Texas Instruments, Freising



5. SYMPOSIUM ELEKTRONIK UND SYSTEMINTEGRATION

ZUKUNFT GESTALTEN – ELEKTRONIK ALS GRUNDLAGE VON INNOVATIONEN

ANMELDUNG | TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Fachbesuch

Die Teilnahme am 5. Symposium Elektronik und Systemintegration (15. April 2026) als Fachbesucher/-in ist **kostenfrei**. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen notwendig. Bitte nutzen Sie für die Anmeldung zur Teilnahme unser online-Portal unter www.symposium-esi.de. Hier finden Sie auch weitere Informationen zur Veranstaltung.

Anmeldeschluss: 10. April 2026

Teilnahme als Aussteller

Sie haben Interesse, Ihre Produkte, Dienstleistungen oder Forschungserkenntnisse als Aussteller auf der begleitenden Fachausstellung zu präsentieren? Für Cluster-Partner, Partner des Symposiums ESI 2026, Hochschulen und natürlich auch Referierende im Symposium gelten Sonderkonditionen. Konditionen für Aussteller (zzgl. MwSt.):

- Referierende im Symposium: 150,00 Euro
- Partner:
 - Unternehmen: 330,00 Euro
 - Hochschulen, Forschungseinrichtungen: 210,00 Euro

Nicht-Partner:

- Unternehmen: 550,00 Euro
- Hochschulen, Forschungseinrichtungen: 350,00 Euro

Weitere Informationen zu Standgröße und -ausstattung sowie die Anmeldung finden Sie im Formular unter www.symposium-esi.de.

Anmeldeschluss für Aussteller: 07. April 2026

Teilnahme Postersession

Die Präsentation eines Posters ist kostenfrei und für angemeldete Unternehmen, Start-ups, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Absolventinnen und Absolventen sowie Studierende des Symposiums möglich. Das Fachkomitee entscheidet über die Zulassung von Plakaten. Nutzen Sie für die Posteranmeldung das Formular unter www.symposium-esi.de.



FORSCHUNGSBEREICH ESI | CLUSTER MST

Intelligente Elektronik- und Sensorsysteme finden starke Verbreitung in Industrie- und Consumerprodukten. Sie erfassen eigenständig Daten, werten sie aus und leiten daraus notwendige Aktionen ab. Im Fokus des **Forschungsbereichs Elektronik und Systemintegration (ESI)** der Hochschule Landshut stehen solche miniaturisierten elektronischen Systeme, ihre einzelnen Komponenten sowie ihre Aufbau- und Verbindungstechnologien. Vorrangig werden die notwendigen Systemkomponenten – Sensoren, Datenverarbeitung, Energiemanagement, Aktorik, Leistungselektronik, Kommunikation – zu einem Gesamtsystem mittels Hybridtechnologie auf Keramiksubstraten aufgebaut.

Die Forschungsaktivitäten umfassen Drittmittelprojekte und Entwicklungsarbeiten im Auftrag von Industriepartnern mit der Möglichkeit der Muster- und Kleinserienproduktion in hochschuleigenen Laboren. Ein wichtiges Anliegen ist dabei die Stärkung der Verbindung zwischen der angewandten Forschung und dem Lehrbetrieb an der Hochschule.

Die am Forschungsbereich Elektronik und Systemintegration beteiligten Professoren arbeiten eng mit dem **Cluster Mikro-systemtechnik (MST)** zusammen. Dieses Kompetenznetzwerk der Hochschule Landshut vereint zumeist kleine und mittlere Unternehmen (KMU) schwerpunktmäßig aus der Region als Mitglieder. Durch die Zusammenarbeit mit den Partnern werden KMUs darin unterstützt, innovative Produkte zu entwickeln. F&E-Aktivitäten erfolgen in Form von Verbundprojekten, die über verschiedene landes-, bundes- oder europaweite Programme gefördert werden.



WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

Prof. Dr. Artem Ivanov
Wissenschaftlicher Leiter Cluster Mikrosystemtechnik,
Sprecher Forschungsbereich Elektronik und System-
integration
HOCHSCHULE LANDSHUT
Tel. +49 (0)871 - 506 266
artem..ivanov@haw-landshut.de

VERANSTALTUNGSORGANISATION

Marc Bicker | Peter Patzelt
Cluster Mikrosystemtechnik
HOCHSCHULE LANDSHUT
Am Lurzenhof 1
84036 Landshut
Tel. +49 (0)871 - 506 134
Fax +49 (0)871 - 506 506
marc.bicker@haw-landshut.de
www.cluster-mst.de
www.symposium-esi.de



Fotos:

Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG (Titel),
Hochschule Landshut

KOOPERATIONSPARTNER



HOCHSCHULE LANDSHUT

Am Lurzenhof 1
84036 Landshut
Tel.: +49 (0)871 - 506 0
info@haw-landshut.de
www.haw-landshut.de

